4H-SiC上の疑似AI基板製作と疑似基板上へのGaN RF-MBE成長

Fabrication of pseudo Al template on 4H-SiC and growth of GaN on pseudo template by RF-MBE.

大澤真弥, 多次見大樹, 山口智広, 本田徹*

工学院大学

Shinya Ohsawa, Daiki Tajimi, Tomohiro Yamaguchi, Tohru Honda Kogakuin Univ.

E-mail: ct11761@ns.kogakuin.ac.jp (T. Honda)

1.はじめに

近紫外発光素子製作に向け、これまでAI 基板上へGaN 薄膜成長検討を行ってきた[1]. 金属である AI 基板上へのGaN 成長は、縦型発光素子応用だけでなく、化学リフトオフプロセス[2]などによる新しい展開が期待できる。本研究室ではSapphireや4H-SiC 基板上にAI を成長し、疑似基板として用いている。しかしながらAI 成長のメカニズムや、AI 上にGaN を成長させることによる影響などはまだ明らかではない。本研究では4H-SiC 基板上へのAI 薄膜(疑似AI 基板)製作を行い、疑似AI 基板上に GaN 成長を行った。

2.実験方法

成長用基板として4H-SiC 基板を使用し、成長方法にはRF-MBE(MBE: Molecular Beam Epitaxy)法を用いた。基板の成長前処理として有機洗浄、無機洗浄を行った後、成長室内にて850℃にてサーマルクリーニングを行った。その後基板温度250℃にて5時間のAl を成長した。その後、基板温度350℃で窒化を行い、表面にAlN 層を形成し、Al の融点以下である650℃にてGaN 成長を行った。製作したサンプルは反射高速電子線回折(RHEED)及びX 線回折(XRD)にて評価を行った。

3.結果及び考察

図1にAI 成長時のRHEED パターンを示す. 図1より成長初期段階ではAI は3次元成長し、成長時間が増していくに連れて2次元成長へと移行していくことがわかる. 図2には疑似AI 基板上にGaN成長を行ったサンプルのXRD 測定結果を示す. 図2よりSiC及びGaN だけでなく(111)AI のピークも確認できたことから、GaN をAI の融点以下で成長することでAI 層を残したまま単結晶GaN 成長を行えることがわかった.

4.結論

今回、RF-MBE 法を用いて4H-SiC 基板上に疑似 Al 基板製作及び、疑似Al 基板上へのGaN 成長を行った. その結果、成長初期段階ではAl は3 次元成長し、成長時間を増加させることで2 次元成長へと移行することがわかった. また、Al の融点以下で GaN 成長を行うことでAl 層を残したまま単結晶 GaN 成長が行えることがわかった.

参考文献

- [1] M. Sawadaishi, S. Taguchi, K. Sasaya, T. Honda, J. Cryst. Growth **311**, 1994 (2009).
- [2] T. Honda, M. Hayashi, Y. Sugiura, I. Takezawa and T. Yamaguchi, Physica Status Solidi C 10, 385 (2013).

筘鵂

本研究の一部は科研費若手研究(A)(#25706020)、 基盤研究(C)(#25420341, #25390071)、東電記念 財団およびJST-ALCAの支援を受けて行われた.

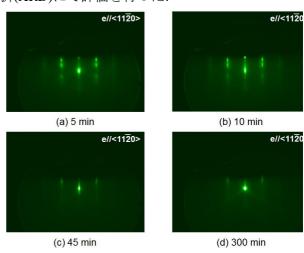


図1 Al 成長時のRHEED パターン.

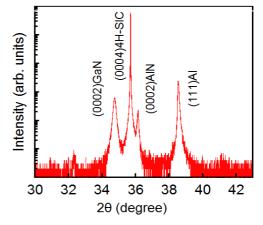


図 2 疑似 AI 基板上 GaN の XRD パターン.